

强于大市

半导体行业周报

业绩全线高增长，存储芯片量价齐升

半导体行业景气依然高企，中芯国际业绩超市场预期，14/28nm 制程占比同比提高，7nm 制程明年进入风险量产。自中美贸易战后，华为芯片断供，国产替代便成为国内半导体行业发展的主旋律，相比半导体制造和封测环节，半导体设备和材料领域国产化率低，国内厂商仍有较大的国产化替代空间。本周共有 12 家半导体公司发布年中报业绩，其中集成电路板块半数公司同比增长超过 45%，半导体材料和封测公司也表现优异。全球经济数字化和万物互联仍旧是半导体行业的发展主题，国产替代将驱动国内半导体产线全面成长。

行业动态：

- **中报业绩全线向好：**本周共有 12 家半导体企业披露 2021 上半年业绩报告，以集成电路、半导体材料、封测企业居多。其中，8 家集成电路企业中，有 6 家的同比增速在 45% 以上，中芯国际年中归母净利润 28.67 亿美元，同比增长 47.53%；芯原股份二季度首度扭亏为盈，富满电子的归母净利润同比增幅则达到了 1190.55%；3 家半导体材料公司中，神工股份上半年盈利同比增幅为 415.40%，中环股份的同比增幅在 174.92%；封测企业里，测试企业利扬芯片的盈利增长为 47.10%。行业景气持续高企，后续其他半导体企业的中报业绩值得期待。
- **目前共 92 家企业拟 IPO：**其中，复旦微电、本川智能已顺利上市。本周另有 3 家半导体公司终止 IPO 流程，分别为碳化硅器件公司瑞能半导、EDA 软件公司芯愿景、薄膜沉积和刻蚀装备制造商微导纳米。
- **半导体设备：**清洗设备龙头盛美半导体 Q2 盈利剧增并上调全年收入指引，设备交付期延后维持设备急需态势。盛美半导体 8 月 6 日发布 2021Q2 财报，显示 Q2 营业收入为 0.54 亿美元，同比上涨 37.94%；Q2 归母净利润为 0.07 亿美元，同比增长 8207.41%，盈利能力大幅提升。盛美单季度发货额环比增长 10.8%，并上调 2021 全年收入指引，表明其设备订单火爆及二季度获得大量订单实现交付。同时，盛美本周公布适用于 3D NAND、DRAM 和先进逻辑制造的边缘湿法刻蚀设备，增量业务将助推公司加速成长。目前因零部件短缺导致设备交付期延长，叠加粤芯二期、中芯绍兴等晶圆厂扩产项目实施，半导体设备仍将持续受益，后续订单收入确认对业绩的积极影响可期。
- **晶圆代工：**晶圆出货增长及售价上调助中芯国际 Q2 盈利大增，成熟制程仍为争夺高地。中芯国际发布 2021Q2 业绩报告，单季度营收和盈利均实现环比和同比增长，其中归母净利润实现同比 398.5%，在公司受国际贸易摩擦的影响下，亮眼业绩主要受益于 Q2 晶圆交付环比增加 12% 带来的销售增长，以及出货均价环比增长 8.8% 带来的毛利提升。Q2 其产品结构重心也移向 FinFET/28nm 等成熟工艺，占比扩大 7.6 个百分点。随着台积电等晶圆大厂陆续上调产品售价，TI 电源管理芯片等成熟工艺产品缺货，国内晶圆厂将受益于价升以及转单的红利。
- **存储芯片：价格需求齐升，产能产值持续恢复。**上周三星电子，SK 海力士发布财报显示营收净利均取得大幅增长，其中三星指出此次营收的大幅提升主要来源于年初以来 DRAM 和 NAND 的出货量和价格增幅均大幅超出预期。SK 海力士认为下半年存储芯片市场将延续此前景气，随着旺季的到来，需求将继续增长。WSTS 预计，2021 年全球半导体产值将达 5272 亿美元，同比增长 19.7%；其中，存储器产值增长 31.7%，增幅位居首位。2022 年全球半导体产值有望达 5734 亿美元，同比增长 8.8%；存储器产值则进一步增长 17.4%。
- **半导体材料：国家大基金入股并向半导体材料领域倾斜，**上周，南大光电通过增资扩股方式引入大基金二期作为战略投资者，成为大基金二期入股的首个半导体材料公司。8 月 6 日，中环股份发布业绩公告，上半年业绩高速增长，大幅超出预期，半导体材料业务板块受下游需求旺盛影响，产销规模同比增长 65.8%。

投资建议：

- **设备组合：**中微公司、北方华创、芯源微、华峰测控、精测电子、万业企业、长川科技；建议关注：晶盛机电
- **材料组合建议关注：**沪硅产业、雅克科技、安集科技、立昂微、彤程新材、晶瑞电材、中环股份、鼎龙股份
- **功率半导体组合：**新洁能、华润微；建议关注：斯达半导、士兰微、闻泰科技
- **模拟建议关注：**圣邦股份、思瑞浦、卓胜微（射频）
- **MCU：**兆易创新；建议关注中颖电子
- **其他：**韦尔股份；建议关注：三安光电、乐鑫科技、恒玄科技

风险提示

疫情影响超预期；半导体设备国产化进程放缓；半导体材料国内市场增速放缓；美国进一步向中国禁售关键半导体设备。

相关研究报告

《半导体新股系列 5 - 华大九天：国内领先的一站式 EDA 服务提供商》20210803

《Lam Research 21Q2 业绩点评及电话会议纪要：单季度收入增长 49%，产品市占率持续提升》20210801

《TI 21Q2 业绩点评及电话会议纪要：Q3 收入指引高位持平，扩产助增汽车 IC 和工业 IC 的市场竞争优势》20210729

中银国际证券股份有限公司
具备证券投资咨询业务资格

电子：半导体

证券分析师：杨绍辉

(8621)20328569

shaohui.yang@bocichina.com

证券投资咨询业务证书编号：S1300514080001

证券分析师：余嫒嫒

(8621)20328550

yuanyuan.yu@bocichina.com

证券投资咨询业务证书编号：S1300517050002

证券分析师：王达婷

(8621)20328284

dating.wang@bocichina.com

证券投资咨询业务证书编号：S1300519060001

目录

半导体企业 2021 上半年业绩报告汇总.....	4
拟 IPO 的半导体企业汇总	5
行业数据回顾	7
上周信息汇总	9
IP & EDA.....	9
半导体设备	9
半导体材料	10
晶圆代工	10
封测	10
功率半导体	10
射频芯片	11
MCU	11
风险提示.....	12

图表目录

图表 1. 本周 2021 上半年半导体企业业绩公告统计表.....	4
图表 2. 半导体拟 IPO 统计表（截止 2021/08/07）	5
续图表 2. 半导体拟 IPO 统计表（截止 2021/08/07）	6
图表 3. 北美半导体设备制造商出货额:当月值（百万美元）	7
图表 4. 美国与国内半导体指数对比	7
图表 5. DRAM 与 NAND Flash 现货平均价格对比（美元）	7
图表 6. 美国与国内半导体指数对比(近十周涨跌幅)	8
图表 7. DRAM 与 NAND Flash 现货平均价格对比（美元）	8

半导体企业 2021 上半年业绩报告汇总

截止 2021/8/7，集成电路类企业盈利能力大幅提升，半导体材料及封测企业增长符合行业高景气。本周共有 12 家半导体企业自愿披露 2021 上半年业绩报告，以集成电路、半导体材料、封测企业居多。其中，8 家集成电路企业中，有 6 家的同比增长在 45% 以上，中芯国际年中归母净利润 28.67 亿美元，同比增长 47.53%；芯原股份二季度首度扭亏为盈，富满电子的归母净利润同比增幅则达到了 1190.55%；3 家半导体材料公司中，神工股份上半年盈利同比增幅为 415.40%，中环股份的同比增幅在 174.92%；封测企业里，测试企业利扬芯片的盈利增长为 47.10%。行业景气持续高企，后续其他半导体企业的中报业绩值得期待。

图表 1. 本周 2021 上半年半导体企业业绩公告统计表

序号	类别	证券代码	证券简称	归属于上市公司股东净利润	同比增长	业绩变动归因	披露时间
1	材料	002129.SZ	中环股份	盈利：14.8 亿元	174.92%	各业务板块产销规模大幅提升，毛利率增加，工厂运营成本持续下降，公司内部治理效果好	8 月 7 日
2	材料	002549.SZ	凯美特气	盈利：5837.26 万元	88.14%	产品价格上涨，二氧化碳产销两旺，较上年同期均有较大增长。	8 月 6 日
3	材料	688233.SH	神工股份	盈利：1 亿元	415.40%	主营产品订单大幅增加，下游需求带动营业收入与利润的同比增长	8 月 3 日
4	设计	300493.SZ	润欣科技	盈利：2,813.64 万元	60.15%	充分发挥产业资源与研发体系的协同效应，通过自研+产业合作的方式拓展新的市场，在智能家电、TWS 耳机、汽车电子、智慧照明等领域的新业务增长显著，芯片方案设计和持续盈利能力得到了显著的提升	8 月 3 日
5	设计	300671.SZ	富满电子	盈利：3.16 亿元	1190.55%	新产品成果显现，加之多项终端应用需求上涨，相关产品供不应求，PMIC、LED 显示驱动芯片出货动能强劲，市占率持续提升，带动公司业绩高速增长；盈利能力大幅提升，毛利率、净利率高速增长。	8 月 3 日
6	设计	688018.SH	乐鑫科技	盈利：1.02 亿元	192.23%	芯片和模组出货量的大幅增长，行业缺货背景下小幅调升产品价格，芯片业务芯片业务盈利能力提升	7 月 31 日
7	设计	688135.SH	利扬芯片	盈利：3963 万元	47.10%	在 5G 通讯、高速光通讯、MCU、高精度 ADC、智能控制等领域的芯片测试保持增量；投资收益较上年同期大幅增加	7 月 31 日
8	设计	688508.SH	芯朋微	盈利：7028 万元	119.93%	集成电路行业持续向好，芯片国产替代加速，公司进一步优化产品结构，在小家电领域保持优势，大家电芯片开始进入大批量量产，实现产品销售收入、利润的增长	8 月 7 日
9	设计	688521.SH	芯原股份-U	亏损：4565 万元	二季度净利润 2260 万扭亏为盈	一站式芯片定制业务增长迅猛，业绩持续稳定增长；在手订单充足，芯片量产业务规模效应显现	8 月 4 日
10	设计	688536.SH	思瑞浦	盈利：1.5 亿元	26.78%	电源管理芯片快速起量、国产替代助力模拟芯片领先企业快速崛起	8 月 5 日
11	设计	688981.SH	中芯国际	盈利：28.67 亿美元	47.53%	行业景气度上升，晶圆代工产能供不应求；成熟工艺产能扩张稳步进行，进一步打开公司成长空间；半导体领域国产化进程逐步推进，公司未来有望深度受益于行业高景气及国产化红利。	
12	材料	600703.SH	三安光电	盈利：8.8 亿元	39.18%	MiniLED 商用的背景下，下游需求猛增，公司产能逐步释放；积极调整产品结构，向中高端芯片领域渗透	7 月 30 日

资料来源：公司公告，中银证券

拟 IPO 的半导体企业汇总

截止 2021/8/7，共有 93 家半导体企业申报 IPO、开展上市辅导等。其中，复旦微电、本川智能已顺利上市。本周另有拓荆科技科创板 IPO 进入问询阶段，拓荆科技于 7 月 12 日提交科创板 IPO 受上交所受理，到此次问询，仅相隔不到一个月时间。

图表 2. 半导体拟 IPO 统计表（截止 2021/08/07）

序号	公司	最新进度	保荐机构	成立时间	类别	核心业务
1	格科微	已注册	中金公司	2003	设计	CMOS 图像传感器、显示驱动芯片
2	艾为电子	已注册	中信证券	2008	设计	高品质数模混合信号、模拟、射频
3	普冉股份	已注册	中信证券	2016	设计	超低功耗 Flash 存储器、高安全 Flash 存储器、高可靠性 EEPROM 存储器
4	中车电气	已注册	中金公司	2005	设计	功率半导体
5	宏微科技	已注册	民生证券	2006	设计	以 IGBT、FRED 为主的功率半导体芯片、单管、模块和电源模组
6	雷电微力	已注册	中信证券	2007	设计	高性能微波及射频 SOC 集成电路
7	华海清科	提交注册	国泰君安	2013	设备	CMP 设备
8	盛美股份	提交注册	海通证券	2005	设备	清洗设备、FN、镀铜设备等
9	灿勤科技	提交注册	中信建投	2004	设计	微波介质陶瓷元器件
10	炬芯科技	提交注册	申万宏源	2014	设计	蓝牙音频 SoC 芯片系列、便携式音视频 SoC 芯片系列、智能语音交互 SoC 芯片系列等
11	东芯股份	提交注册	海通证券	2014	设计	24nm NAND、48nm NOR
12	【苏州】国芯科技	提交注册	国泰君安	2001	设计	国产自主 32 位高性能嵌入式 CPU 开发、嵌入式产品设计和应用
13	翱捷科技	提交注册	海通证券	2015	设计	全制式蜂窝基带芯片及多协议非蜂窝物联网芯片
14	安路科技	提交注册	中金公司	2011	设计	可编程逻辑器件 (FPGA)、可编程系统级芯片 (SoC)、及相关 EDA 软件工具和创新系统解决方案
15	云天励飞	过会	中信证券	2014	设计	AI 芯片
16	芯导科技	问询	国元证券	2009	设计	功率
17	华卓精科	问询	东兴证券	2012	零部件	光刻机双工件台
18	中图科技	问询	申万宏源	2013	材料	图形化蓝宝石衬底
19	希荻微	问询	民生证券、中金公司	2012	设计	高性能模拟集成电路
20	芯导电子	问询	国元证券	2009	设计	功率半导体
21	英集芯科技	问询	华泰联合	2014	设计	数模混合集成电路芯片
22	博蓝特半导体	问询	渤海证券	2012	材料	GaN 基 LED 芯片（图形化）衬底及第三代半导体材料
23	江波龙	问询	中信建投	1999	设计	嵌入式存储、固态硬盘存储、微存储、汽车存储等
24	东微半导体	问询	中金公司	2008	设计	高性能功率器件
25	莱特光电	问询	中信证券	2010	材料	OLED 有机材料
26	华大九天	问询	中信证券	2009	软件	EDA 软件
27	天岳先进	问询	海通证券	2010	材料	半绝缘型和导电型碳化硅衬底
28	甬矽电子	问询	平安证券	2019	封测	封测
29	屹唐股份	问询	国泰君安、中金公司	2015	设备	刻蚀、去胶、退火
30	概伦电子	问询	招商证券	2010	软件	EDA 软件
31	峰岷科技	问询	海通证券	2010	设计	电机驱动控制芯片
32	拓荆科技	问询	招商证券	2010	设备	离子体增强化学气相沉积 (PECVD) 设备、原子层沉积 (ALD) 设备、次常压化学气相沉积 (SACVD) 设备
33	德明利	已申报	东莞证券	2008	设计	闪存主控芯片，存储模组产品应用方案
34	麦斯克	已申报	国泰君安	1995	材料	硅片
35	纳芯微	已申报	光大证券	2013	设计	车规级传感器及信号链芯片
36	晶合集成	已申报	中金公司	2015	设计	面板驱动芯片
37	必易微	已申报	申万宏源	2009	设计	高性能模拟及混合信号集成电路
38	思科瑞	已申报	中国银河证券	2014	测试	分立器件及晶圆测试
39	唯捷创芯	已申报	中信建投	2010	设计	射频前端及高端模拟芯片
40	路维光电	已申报	国信证券	2012	材料	掩模板
41	赛微微	已申报	国泰君安	2009	设计	电源管理芯片

资料来源：上交所、深交所、公司官网、中银证券

续图表 2. 半导体拟 IPO 统计表 (截止 2021/08/07)

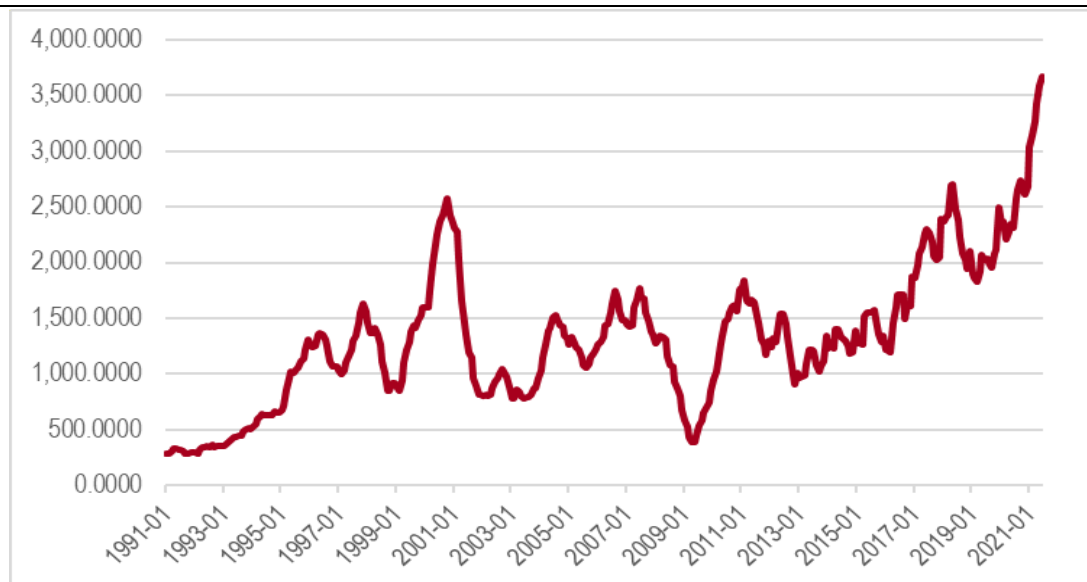
序号	公司	最新进度	保荐机构	成立时间	类别	核心业务
42	中微股份	已申报	中信证券	2001	设计	混合信号 SoC
43	龙腾半导体	已申报	国信证券	2009	设计	新型功率半导体器件
44	盛景微	已申报	光大证券	2016	设计	物联网控制芯片
45	臻镭科技	已申报	中信证券	2015	设计	射频芯片、电源管理芯片
46	思特威	已申报	中信建投	2011	设计	CMOS 图像传感器芯片
47	金海通	已申报	海通证券	2012	设备	高温 IC 自动测试 Pick-Place 分选机
48	天德钰	已申报	中信证券	2010	设计	智能移动终端显示屏驱动芯片、摄像头音圈马达驱动芯片、快速充电协议芯片、电子价签驱动芯片及解决方案
49	奥比中光	已申报	中信建投	2013	设计	深度引擎数字芯片、专用感光模拟芯片
50	好达电子	已申报	安信证券	1999	设计	SAW Filter
51	比亚迪半导体	已申报	中金公司	2004	设计	功率半导体
52	龙芯中科	已申报	中信证券	2010	设计	CPU
53	烨映微	已申报	海通证券	2016	设计	MEMS 非制冷热电堆红外传感器
54	广立微	已申报	中金公司	2003	软件	EDA 软件、电路 IP、晶圆级电性测试设备
55	炬光科技	已申报	中信建投	2007	设计	高功率半导体激光器及微光学相关产品
56	铖昌科技	已申报	国信证券	2010	设计	微波毫米波射频芯片
57	长光华芯	已申报	华泰联合	2012	设计	高功率半导体激光器芯片等
58	【杭州】国芯科技	已申报	中信证券	2001	设计	数字电视芯片、面向物联网人工智能芯片
59	国博电子	完成上市辅导	招商证券	2010	设计	射频
60	艾森半导体	上市辅导	华泰联合	2010	材料	光刻胶及配套高纯化学品
61	江苏影速	上市辅导	中金公司	2014	设备	激光直写的光刻机设备
62	上海微	上市辅导		2002	设备	光刻机
63	矽电半导体	上市辅导	招商证券	2003	设备	探针台
64	中科飞测	上市辅导	国泰君安	2014	设备	量测设备
65	海光信息	上市辅导	中信证券	2014	设计	CPU
66	苏州赛芯微	上市辅导	国泰君安	2009	设计	模拟芯片
67	芯龙半导体	上市辅导	海通证券	2007	设计	电源管理类模拟集成电路
68	耐科装备	上市辅导	国元证券	2005	设备	半导体封装装备
69	上海伟测	上市辅导	平安证券	2016	测试	晶圆测试和芯片成品测试
70	芯动联科	上市辅导	中信建投	2012	设计	MEMS
71	芯微电子	上市辅导	国金证券	1998	设计	功率半导体分立器件
72	禹龙通	上市辅导	招商证券	2005	设计	大功率射频电阻, 同轴负载、衰减器、波导系列无源器件、碳化硅及橡胶板吸波材料
73	吉莱电子	上市辅导	长江证券	2001	设计	单、双向晶闸管全系列, 低频功率三极管、单、双向 TVS 保护管、双向 (防静电) 放电管
74	富创精密	上市辅导	中信证券	2008	零部件	半导体设备精密零部件加工制造及表面处理
75	源杰半导体	上市辅导	国泰君安	2013	设计	激光器芯片
76	新顺微电子	上市辅导	华泰联合	2002	设计	功率半导体
77	微源半导体	上市辅导	海通证券	2010	设计	电源管理芯片
78	南麟电子	上市辅导	国金证券	2004	设计	模拟和数模混合类集成电路的设计与研究
79	国微思尔芯	上市辅导	中金公司	2003	软件	EDA
80	芯天下	上市辅导	中信建投	2014	设计	NOR Flash
81	灿芯半导体	上市辅导	海通证券	2008	软件	定制化芯片 (ASIC) 设计方案提供商及 IP 供应商
82	杰华特	上市辅导	中信证券	2013	设计	电源管理芯片
83	安凯微电子	上市辅导	东方证券	2000	设计	物联网摄像机核心芯片、蓝牙芯片以及应用处理器芯片
84	易兆微	上市辅导	海通证券	2014	设计	短距离无线通讯芯片
85	辉芒微	上市辅导	中信证券	2005	设计	专注于非易失性存储芯片(NVM)、数模混合信号设计、高端模拟电路、高压电源管理芯片
86	飞驒科技	上市辅导	中金公司	2015	设计	射频芯片
87	通美晶体	上市辅导	海通证券	1998	材料	砷化镓、磷化铟等在内的 III-V 族化合物及单晶锗半导体衬底材料
88	蕊源半导体	上市辅导	中金公司	2016	设计	电源管理
89	上海超硅	上市辅导	中金公司	2008	材料	大硅片
90	沈阳拓荆	上市辅导	招商证券	2010	设备	薄膜沉积设备
91	汇成真空	上市辅导	东莞证券	2006	设备	真空应用设备
92	中巨芯	上市辅导	海通证券	2017	材料	电子湿化学品、电子特种气体、半导体前驱体
93	锐成芯微	上市辅导	华泰联合	2011	软件	IP 授权

资料来源: 上交所、深交所、公司官网、中银证券

行业数据回顾

5月北美半导体设备出货金额 36.7 亿美元，连续六个月创新高。据 SEMI 统计，6 月北美半导体设备出货金额继续创新高，较 5 月的 35.9 亿美元提升 2.3%，较 2020 年同期 23.2 亿美元上升 58.4%。2021 年 1-6 月份出货额的环比增幅分别为 13.3%、3.5%、4.2%、4.7%、4.7%、2.3%。

图表 3. 北美半导体设备制造商出货额:当月值 (百万美元)



资料来源: Wind, SEMI, 中银证券

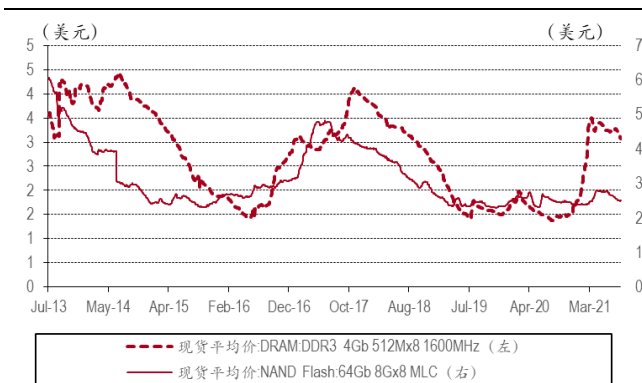
国内半导体指数创新高后回落,存储周度价格有高位滑落迹象。近一周申万行业半导体指数下跌 5.7% 但仍保持在历史高位水平,已从上周最高点 7642.58 回落近 8.1%,国内半导体行业表现仍属强劲。费城半导体指数在高位小波幅维稳且趋势向上。近一周存储现货平均价较前期继续下行, NAND Flash 64Gb 8Gx8 MLC 连续下滑并在上周下跌 3.8%,跌幅创近几个月新高, DRAM:DDR3 4Gb 512Mx8 1600MHz 连续 3 周现货平均价跌幅缩窄但波动幅度逐渐减弱。

图表 4. 美国与国内半导体指数对比



资料来源: 万得、中银证券

图表 5. DRAM 与 NAND Flash 现货平均价格对比 (美元)



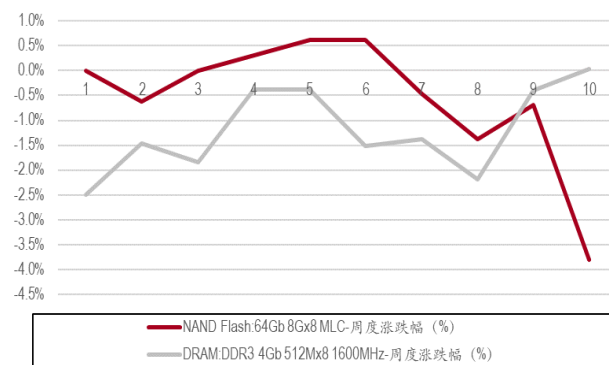
资料来源: 万得、中银证券

图表 6. 美国与国内半导体指数对比(近十周涨跌幅)



资料来源：万得、中银证券

图表 7. DRAM 与 NAND Flash 现货平均价格对比 (美元)



资料来源：万得、中银证券

上周信息汇总

IP & EDA

【行业】海关总署：前7个月集成电路进口3682.9亿个 同比增加27.4%

2021年8月7日，海关总署数据显示，前7个月集成电路进口3682.9亿个，同比增加27.4%，价值1.51万亿元，增长17.1%；汽车（包括底盘）61.5万辆，增加43.2%，价值2159.4亿元，增长51.2%。

（资料来源：金融界）

【中芯国际】中芯国际第二季度净利增长近4倍，CEO梁孟松称集成电路制造无法弯道超车

8月5日中芯国际公告：2021年第二季度营收13.4亿美元，市场预估13亿美元；第二季度净利润6.878亿美元，同比增长398.5%，市场预估2.778亿美元。

公司表示，2021年第二季销售收入变动主要由于晶圆付运量增加及平均售价上升所致。中芯国际CEO梁孟松表示，中芯国际一直在困境中前行。经营连续性上，成熟工艺的不确定性风险进一步降低。梁孟松还称，集成电路制造业没有弯道式超车和跳跃式前进，公司会一步一个脚印提高核心竞争力。

（资料来源：ZAKER）

半导体设备

【行业】ASML ArF设备交期延长至2年！半导体设备荒正在加剧

半导体协会8月6日讯，据韩国半导体企业相关人士和TheElec收集的全球半导体企业数据显示，截至7月，半导体设备的平均交货周期已延长至14个月，一些晶圆厂设备的交货时间超过了两年。

TheElec指出，去年，晶圆厂设备的交货期在3到6个月之间，今年第一季度延长到了平均10个月。交期的延长是由于芯片制造商增加了对晶圆厂的支出，以及全球芯片短缺的长期化，甚至连设备制造商都要采购他们产品所需的芯片。

部分知情人士表示，用于前端工序的设备，通常有较短的交货期，但目前其交期平均也超过了一年。设备的交货时间总体上处于历史最高水平。

（资料来源：半导体协会）

【晶盛机电】：与半导体设备龙头美国应材合作；打造光伏设备产业链平台公司-浙商机械

新浪8月5日讯，公司近日公告拟与美国应用材料通过向晶盛全资子公司浙江科盛装备增资的方式成立合资公司，注册资本为1.5亿美元。其中，公司参股65%（出资9750万美元），应用材料香港参股35%（出资5250万美元）。收购应用材料晶片检测、丝印设备业务，拓宽产品品类；丰富光伏设备产品线，打造产业链平台型公司。

（资料来源：新浪）

半导体材料

【行业】科院实现半导体材料“异构外延”突破 石墨烯产业化应用迎新思路

巨丰财经 8 月 3 日讯，近期，中科院半导体研究所与北京大学、北京石墨烯研究院等科研团队合作，实现了石墨烯玻璃晶圆氮化物“异构外延”突破，证实了氮化物外延摆脱衬底限制的可能性。研究人员提出一种纳米柱辅助的范德华外延方法，首次在玻璃衬底上成功外延出连续平整的准单晶氮化镓 (GaN) 薄膜，并制备出蓝光发光二极管 (LED)。相关成果 7 月 30 日发表于《科学》子刊《科学·进展》。

(资料来源：巨丰财经)

晶圆代工

【行业】传台湾晶圆代工厂明年一季度前将对成熟制程再提价

据 Digitimes 报道称，据 IC 设计公司的消息人士透露，台湾多家晶圆代工厂准备在 2022 年第一季度之前提高成熟制程的 8 英寸和 12 英寸晶圆报价，提价幅度至少为 5-10%。在台湾晶圆代工厂当中，联电的涨价最为频繁。在去年年底，联电就通知客户，今年初 8 英寸晶圆代工报价将调涨 10%。随后，联电又在今年 4 月初宣布，8 英寸晶圆代工再涨 10%，12 寸则首度调价，涨幅为 10%。4 月末，联电又宣布，7 月晶圆代工出货的价格，8 寸和 12 寸均将调涨 15%。预计在 9 月，联电将再度调涨晶圆代工报价，不过涨幅较之前应该会收窄。根据估算，今年一整年，联电的 8 英寸晶圆代工价格涨幅将突破五成，12 寸也会超过三成。

(资料来源：中电网)

封测

【光力科技】光力科技 1.17 亿增持先进微电子半导体封测业务营收占比增至 39%

8 月 3 日晚间，光力科技发布公告称，公司全资子公司光力瑞弘进一步收购先进微电子装备约 25.51% 股权。收购完成后，光力科技持有先进微电子的股权将由 69.39% 增加至 94.9%。

目前先进微电子的主要运营资产是 ADT 公司 100% 股权。ADT 公司是全球第三大半导体切割划片设备制造商，前身为美国 K&S 公司以色列切割设备及刀片业务部门。ADT 公司主营业务为在全球范围内面向半导体、微电子行业提供研发、制造和销售划片机设备、刀片和设备耗材，并按照客户需求提供定制化的切割解决方案。产品主要应用于半导体、微电子后道封测装备领域，客户覆盖全球主要市场。

2020-2021 年上半年，标的公司实现营收分别为 1.43 亿元、1.37 亿元，实现净利润分别为 -7332.16 万元、1410.01 万元，今年上半年扭亏为盈。

(资料来源：公司公告)

功率半导体

【皇庭国际】地产商也来造芯片？皇庭国际拟收购意发功率半导体引深交所关注

8 月 3 日，主营商业不动产综合运营服务的皇庭国际发布公告称，拟以 4600 万元间接参股半导体公司意发功率半导体。

资料显示，意发功率半导体主要从事功率半导体器件及智能功率控制器件的设计、制造及销售，具备从芯片设计、晶圆制造到模组设计一体化的能力，产品广泛应用于工控通信、工业感应加热、光伏发电、风力发电、充电桩和新能源车等领域。

皇庭国际在公告中表示，本次收购是公司围绕“商管+科技”发展战略布局半导体行业的第一步，有助于公司形成新的业务。未来，公司将以意发功率半导体为基础，通过扩大再生产、产业链上下游的延伸等多种途径，提高上市公司盈利能力。

（资料来源：证券之星）

【行业】斥资10亿！TCL加码功率半导体赛道

8月2日中电网讯，公司目前已成立TCL微芯科技（广东）有限公司（以下简称“TCL微芯”）作为公司半导体业务平台，并持续围绕集成电路芯片设计、半导体功率器件等领域寻找产业拓展机会。

（资料来源：中电网）

射频芯片

【卓胜微】射频芯片迎来黄金时代，国内射频龙头遇发展新机会

卓胜微作为国内射频龙头企业，自2021年以来公司股价累计上涨超50%，大幅超越大盘指数，而卓胜微备受市场追捧主要得益于产品市场需求持续增长，公司核心技术明显，以及拥有丰厚的客户资源。卓胜微已形成了面向长远的人才梯队。截至2020年底，卓胜微的研发人员增长至202人，同比增长38.36%。企业综合竞争力的提升离不开技术进步，技术研发能力是一个公司经营的有力保障。长期以来，卓胜微持续加强研发管理和研发投入，2020年，研发投入达到1.82亿，同比增长32.43%。通过新设计、新工艺和新材料的结合，将公司产品朝着高端化、复杂化方向研发。截至2020年年末，卓胜微共计取得63项专利，其中国内专利62项（包含发明专利51项）、国际专利1项（该项为发明专利）；10项集成电路布图设计。

（资料来源：搜狐）

MCU

【行业】汽车芯片短缺调查：MCU芯片涨价5-20倍，有经销商囤货涨价

8月3日中午，国家市场监管总局发布公告称，针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题，根据价格监测和举报线索，对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。红星资本局调查发现，有部分二级经销商提前囤货，再以高价卖出。车用MCU由于需求量大、车企库存消耗过快，晶圆厂产能调配以及扩产所需时间长，在目前芯片市场供需错配造成的结构性失衡的情况下，MCU缺货尤为严重。

在芯片短缺的情况下，其价格也迎来了暴涨。涨价是从今年年初开始的，汽车芯片在主流渠道涨了5-10倍，非主流渠道甚至可能涨了10-20倍。

（资料来源：澎湃新闻）

【行业】台积电占全球车用MCU总代工的60%-70%

据中国台湾地区经济日报8月7日报道，市场高度关注车用芯片市场状况，晶圆代工龙头台积电总裁魏哲家日前指出，台积电今年MCU的产量将较去年提升60%，预期客户车用半导体元件短缺现象可望在第3季改善。资策会产业情报研究所（MIC）资深分析师郑凯安指出，目前车用MCU外包比重高达60%到70%由台积电代工，台积电在全球车用MCU生产占有关键地位。

（资料来源：经济日报）

风险提示

疫情影响超预期：新冠疫情仍处于全球蔓延阶段，若新冠疫情影响超预期，可能造成全球系统性风险及行业需求不达预期风险。

半导体设备国产化进程放缓：新一轮设备采购中，因进口品牌已深切感受到来自国产设备替代进口设备的经营压力，进口品牌可能通过降价压制国产设备扩大市场份额。

半导体材料国内市场增速放缓：半导体材料从世界范围来看是个增速较为缓慢的市场，中国市场在过去 5 年中 CAGR 达到了 10%，远高于世界平均水平。若半导体材料进入下行周期，目前国内市场的增速将难以持续。

美国进一步向中国禁售关键半导体设备：由于本土晶圆厂对美国设备的依赖度接近 50%，因此一旦美国对出口至我国的关键半导体设备进行约束，我国本土晶圆厂的建产进度将受到影响。

披露声明

本报告准确表述了证券分析师的个人观点。该证券分析师声明，本人未在公司内、外部机构兼任有损本人独立性与客观性的其他职务，没有担任本报告评论的上市公司的董事、监事或高级管理人员；也不拥有与该上市公司有关的任何财务权益；本报告评论的上市公司或其它第三方都没有或没有承诺向本人提供与本报告有关的任何补偿或其它利益。

中银国际证券股份有限公司同时声明，将通过公司网站披露本公司授权公众媒体及其他机构刊载或者转发证券研究报告有关情况。如有投资者于未经授权的公众媒体看到或从其他机构获得本研究报告的，请慎重使用所获得的研究报告，以防止被误导，中银国际证券股份有限公司不对其报告理解和使用承担任何责任。

评级体系说明

以报告发布日后公司股价/行业指数涨跌幅相对同期相关市场指数的涨跌幅的表现为基准：

公司投资评级：

买入：预计该公司股价在未来 6-12 个月内超越基准指数 20%以上；
增持：预计该公司股价在未来 6-12 个月内超越基准指数 10%-20%；
中性：预计该公司股价在未来 6-12 个月内相对基准指数变动幅度在-10%-10%之间；
减持：预计该公司股价在未来 6-12 个月内相对基准指数跌幅在 10%以上；
未有评级：因无法获取必要的资料或者其他原因，未能给出明确的投资评级。

行业投资评级：

强于大市：预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现强于基准指数；
中性：预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现基本与基准指数持平；
弱于大市：预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现弱于基准指数；
未有评级：因无法获取必要的资料或者其他原因，未能给出明确的投资评级。

沪深市场基准指数为沪深 300 指数；新三板市场基准指数为三板成指或三板做市指数；香港市场基准指数为恒生指数或恒生中国企业指数；美股市场基准指数为纳斯达克综合指数或标普 500 指数。

风险提示及免责声明

本报告由中银国际证券股份有限公司证券分析师撰写并向特定客户发布。

本报告发布的特定客户包括：1) 基金、保险、QFII、QDII 等能够充分理解证券研究报告，具备专业信息处理能力的中银国际证券股份有限公司的机构客户；2) 中银国际证券股份有限公司的证券投资顾问服务团队，其可参考使用本报告。中银国际证券股份有限公司的证券投资顾问服务团队可能以本报告为基础，整合形成证券投资顾问服务建议或产品，提供给接受其证券投资顾问服务的客户。

中银国际证券股份有限公司不以任何方式或渠道向除上述特定客户外的公司个人客户提供本报告。中银国际证券股份有限公司的个人客户从任何外部渠道获得本报告的，亦不应直接依据所获得的研究报告作出投资决策；需充分咨询证券投资顾问意见，独立作出投资决策。中银国际证券股份有限公司不承担由此产生的任何责任及损失等。

本报告内含保密信息，仅供收件人使用。阁下作为收件人，不得出于任何目的直接或间接复制、派发或转发此报告全部或部分内容予任何其他人士，或将此报告全部或部分内容发表。如发现本研究报告被私自刊载或转发的，中银国际证券股份有限公司将及时采取维权措施，追究有关媒体或者机构的责任。所有本报告内使用的商标、服务标记及标记均为中银国际证券股份有限公司或其附属及关联公司（统称“中银国际集团”）的商标、服务标记、注册商标或注册服务标记。

本报告及其所载的任何信息、材料或内容只提供给阁下作参考之用，并未考虑到任何特别的投资目的、财务状况或特殊需要，不能成为或被视为出售或购买或认购证券或其它金融票据的要约或邀请，亦不构成任何合约或承诺的基础。中银国际证券股份有限公司不能确保本报告中提及的投资产品适合任何特定投资者。本报告的内容不构成对任何人的投资建议，阁下不会因为收到本报告而成为中银国际集团的客户。阁下收到或阅读本报告须在承诺购买任何报告中所指之投资产品之前，就该投资产品的适合性，包括阁下的特殊投资目的、财务状况及其特别需要寻求阁下相关投资顾问的意见。

尽管本报告所载资料的来源及观点都是中银国际证券股份有限公司及其证券分析师从相信可靠的来源取得或达到，但撰写本报告的证券分析师或中银国际集团的任何成员及其董事、高管、员工或其他任何个人（包括其关联方）都不能保证它们的准确性或完整性。除非法律或规则规定必须承担的责任外，中银国际集团任何成员不对使用本报告的材料而引致的损失负任何责任。本报告对其中所包含的或讨论的信息或意见的准确性、完整性或公平性不作任何明示或暗示的声明或保证。阁下不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断。本报告仅反映证券分析师在撰写本报告时的设想、见解及分析方法。中银国际集团成员可发布其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告，亦有可能采取与本报告观点不同的投资策略。为免生疑问，本报告所载的观点并不代表中银国际集团成员的立场。

本报告可能附载其它网站的地址或超级链接。对于本报告可能涉及到中银国际集团本身网站以外的资料，中银国际集团未有参阅有关网站，也不对它们的内容负责。提供这些地址或超级链接（包括连接到中银国际集团网站的地址及超级链接）的目的，纯粹为了阁下的方便及参考，连结网站的内容不构成本报告的任何部份。阁下须承担浏览这些网站的风险。

本报告所载的资料、意见及推测仅基于现状，不构成任何保证，可随时更改，毋须提前通知。本报告不构成投资、法律、会计或税务建议或保证任何投资或策略适用于阁下个别情况。本报告不能作为阁下私人投资的建议。

过往的表现不能被视作将来表现的指示或保证，也不能代表或对将来表现做出任何明示或暗示的保障。本报告所载的资料、意见及预测只是反映证券分析师在本报告所载日期的判断，可随时更改。本报告中涉及证券或金融工具的价格、价值及收入可能出现上升或下跌。

部分投资可能不会轻易变现，可能在出售或变现投资时存在难度。同样，阁下获得有关投资的价值或风险的可靠信息也存在困难。本报告中包含或涉及的投资及服务可能未必适合阁下。如上所述，阁下须在做出任何投资决策之前，包括买卖本报告涉及的任何证券，寻求阁下相关投资顾问的意见。

中银国际证券股份有限公司及其附属及关联公司版权所有。保留一切权利。

中银国际证券股份有限公司

中国上海浦东
银城中路 200 号
中银大厦 39 楼
邮编 200121
电话: (8621) 6860 4866
传真: (8621) 5888 3554

相关关联机构：

中银国际研究有限公司

香港花园道一号
中银大厦二十楼
电话: (852) 3988 6333
致电香港免费电话：
中国网通 10 省市客户请拨打：10800 8521065
中国电信 21 省市客户请拨打：10800 1521065
新加坡客户请拨打：800 852 3392
传真: (852) 2147 9513

中银国际证券有限公司

香港花园道一号
中银大厦二十楼
电话: (852) 3988 6333
传真: (852) 2147 9513

中银国际控股有限公司北京代表处

中国北京市西城区
西单北大街 110 号 8 层
邮编: 100032
电话: (8610) 8326 2000
传真: (8610) 8326 2291

中银国际(英国)有限公司

2/F, 1 Lothbury
London EC2R 7DB
United Kingdom
电话: (4420) 3651 8888
传真: (4420) 3651 8877

中银国际(美国)有限公司

美国纽约市美国大道 1045 号
7 Bryant Park 15 楼
NY 10018
电话: (1) 212 259 0888
传真: (1) 212 259 0889

中银国际(新加坡)有限公司

注册编号 199303046Z
新加坡百得利路四号
中国银行大厦四楼(049908)
电话: (65) 6692 6829 / 6534 5587
传真: (65) 6534 3996 / 6532 3371